

 '04年3月期 中間決算説明会補足説明資料
The First Half Year ended September 30,2003
Analyst Guide

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)
Ferrotec Corporation Code-No.6890 (JASDAQ)

2003年12月3日
Dec. 03, 2003

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method		1
2. 連結貸借対照表 (資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)		2
3. 連結貸借対照表 (負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)		3
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income		4
5. 期初計画と実績との差異 Review in the first half		5
6. 連結損益計算書 (計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)		6
7. 期初計画と修正計画との差異 Outline of the revised plan		7
8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows		8
9. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)		9
10. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products		10

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.
We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.
Unless otherwise stated, estimates or forecasts are solely those of our company as of the above-mentioned date and subject to change without notice.
We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.
This report isn't intended for the use of private investors.

1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

連結子会社10社、持分法適用会社1社 Consolidated Subsidiaries (10), Company Accounted for by the Equity method(1)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals、Thermo-electric Modules、CMS	2,546百万円 2,546million yen	98.2%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferrofluid、Thermo-electric Modules、CMS	2,079百万円 2,079million yen	99.1%
杭州日磁科技工業園有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	450百万円 450million yen	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals、Quartz	130万シンガポールドル 1.3mil Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs、Thermo-electric Modules	25百万ドル \$ 25million	100.0%
Ferrotec Investments LLC	米国 USA	その他 Others	46百万円 46million yen	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	EB - ガン、その他 EB-gun、Others	511千ユーロドル 511thousand euro dollar	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs、Others	226百万円 226million yen	100.0%
(株)フェローテッククォーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェーハ Silicon products、CMS	181百万円 181million yen	100.0%
持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック (株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Lithium-Ion Rechargeable Battery	480百万円 480million yen	49.0%

2.連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (As)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	03/3		03/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 GrowthRate	
流動資産	Current assets	10,543	37.3	9,685	34.5	858	8.1	真空シール518百万円、石英製品1,044百万円が主な内訳
現金及び預金	Cash and Deposits	2,860	10.1	2,336	8.3	524	18.3	
受取手形・売掛金	Notes and accounts receivable	3,444	12.2	3,542	12.6	98	2.8	
たな卸資産	Inventories	2,971	10.5	2,969	10.6	2	0.1	
その他	Other assets	1,374	4.9	947	3.4	427	31.1	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	108	0.4	110	0.4	2	1.9	
固定資産	Fixed assets	17,736	62.7	18,389	65.5	653	3.7	主に上海子会社CMS設備により増加 主に上海子会社CMS設備へ振替減少
有形固定資産	Tangible fixed assets	11,195	39.6	11,576	41.2	381	3.4	
建物・構築物	Building and Structures	3,631	12.8	3,795	13.5	164	4.5	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	2,634	9.3	3,677	13.1	1,043	39.6	
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	1,198	4.2	1,108	3.9	90	7.5	
土地	Land	2,673	9.5	2,681	9.5	8	0.3	
建設仮勘定	Construction in progress	1,057	3.7	313	1.1	744	70.4	
無形固定資産	Intangible fixed assets	2,980	10.5	2,987	10.6	7	0.2	
営業権	Goodwill	1,928	6.8	1,919	6.8	9	0.5	
その他	Other assets	1,051	3.6	1,067	3.8	16	1.5	
投資その他の資産	Investments and other assets	3,560	12.6	3,825	13.6	265	7.4	主にアメリカゴン株式追加取得
投資有価証券	Investment securities	1,273	4.5	1,646	5.9	373	29.3	
その他	Other assets	2,308	8.2	2,196	7.8	112	4.9	
貸倒引当金	Allowance for doubtful assets	21	0.1	17	0.1	4	19.0	
資産合計	Total assets	28,279	100.0	28,075	100.0	204	0.7	

参考：換算レート表

	02/3期		02/9期		03/3期		03/9期	
	01/12	02/3	02/6	02/9	02/12	03/3	03/6	03/9
US\$	131.95	133.25	119.50	122.60	119.90	120.20	119.80	111.25
Singapore \$	71.12	72.36	67.71	68.98	69.16	68.01	68.12	64.37
RMB	15.87	16.02	14.51	14.73	14.49	14.51	14.43	13.45

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

3.連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	03/3		03/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 GrowthRate	
流動負債	Current liabilities	8,624	30.5	8,771	31.2	147	1.7	有利子負債の内容 短期借入金 + 1年内長期借入金 5,632 (5,522)百万円 長期借入金+社債 5,669 (5,532)百万円 合計 11,301 (11,054)百万円 *カッコ内は03/3期末
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,053	3.7	1,071	3.8	18	1.7	
短期借入金	Short-term borrowings	3,363	11.9	3,212	11.4	151	4.5	
1年内返済予定長借	Current portion of long-term borr.	2,159	7.6	2,420	8.6	261	12.1	
賞与引当金	Accrued corporation taxes	127	0.4	100	0.4	27	21.3	
その他	Other current liabilities	1,921	6.8	1,966	7.0	45	2.3	
固定負債	Long-term liabilities	5,778	20.4	5,858	20.9	80	1.4	
社債	Bonds	599	2.1	566	2.0	33	5.5	
長期借入金	Long-term borrowings	4,933	17.4	5,103	18.2	170	3.4	
その他	Other long-term liabilities	245	0.9	189	0.7	56	22.9	
負債合計	Total Liabilities	14,403	50.9	14,629	52.1	226	1.6	
少数株主持分	Minority interests	51	0.2	53	0.2	2	3.9	
資本金	Common stock	5,824	20.6	5,824	20.7	0	0.0	
資本剰余金	Capital surplus	6,700	23.7	6,700	23.9	0	0.0	
利益剰余金	Profit surplus	1,075	3.8	438	1.6	637	59.3	
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	76	0.3	116	0.4	192	252.6	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	399	1.4	471	1.7	72	18.0	
自己株式	Treasury stock-at cost	99	0.3	160	0.6	61	-	
資本合計	Total shareholders' equity	13,824	48.9	13,391	47.7	433	3.1	
負債、少数株主持分及び資本合計		28,279	100.0	28,075	100.0	204	0.7	
Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity								

*事業セグメントと製品区分 Business Segments and Product Lines

装置関連	Equipment related	電子デバイス	Electronic device	受託生産	CMS
真空シール 部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Site
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon related products	磁性流体・その他	Ferrofluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	ハードディスク関	HDD products		

4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	02/9		03/9		前期比 GrowthRate	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	6,262	100.0	6,824	100.0	9.0	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1)装置関連 :前期までCMSに計上していたシリコン製品を当期より装置関連に計上、実質減収。原因は真空シールの減少。</p> <p>(2)電子デバイス :サーモが53%弱増収となったが、他の製品が減収</p> <p>(3)CMS :ウエーハ加工が拡大</p> <p>2. 売上総利益減少要因</p> <p>(1)立ち上げ期にあったウエーハ加工事業のコスト負担増</p> <p>(2)粗利率の高い製品の減少</p> <p>(3)中国子会社におけるSARS対策費の発生</p> <p>3. 経費全般の削減と円高により増収ながら販管費減少</p> <p>4. 中間期末間近に円高が進行し、主に親会社の債権・債務の為替評価により為替差損が発生</p> <p>5. 特別損益の主な内容</p> <p>特別利益 :投資有価証券売却益 39百万円、固定資産売却益 8百万円</p> <p>特別損失 :投資有価証券評価損 164百万円、工場閉鎖費用 135百万円</p>
売上原価	Cost of sales	3,781	60.4	4,678	68.5	23.7	
売上総利益	Gross profit	2,481	39.6	2,146	31.5	13.5	
販管費	SG&A expenses	2,156	34.4	2,129	31.2	1.3	
営業利益 (A)	Operating Income	324	5.2	16	0.2	95.1	
営業外収益	Other income	97	1.5	92	1.4	5.2	
受取利息 配当金	Interest & Dividend Income	33	0.5	22	0.3	33.3	
賃貸収入	Lease income	25	0.4	19	0.3	24.0	
その他	Other income	38	0.6	50	0.8	31.6	
営業外費用	Other expense	509	8.1	376	5.6	26.1	
支払利息	Interest expense	112	1.8	155	2.3	38.4	
出資金評価損	Loss on devaluation of investments	-	-	48	0.7	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	-	-	81	1.2	-	
為替差損	Foreign exchange loss	294	4.7	51	0.7	82.7	
その他	Other expense	102	1.6	40	0.6	60.8	
経常利益	Recurring income	87	1.4	267	3.9	-	
特別利益	Extraordinary gain	110	1.8	55	0.8	50.0	
特別損失	Extraordinary loss	140	2.3	331	4.9	136.4	
税前利益	Income before taxes	116	1.9	543	8.0	-	
法人税等	Income tax (current)	43	0.7	42	0.6	-	
同 調整額	Income tax (deferred)	11	0.2	0	0.0	-	
少数株主利益	Minority interest	2	0.1	0	0.0	-	
当期利益	Net income	168	2.7	499	7.3	-	
設備投資	Capital expenditures	1,052		1,136			
減価償却費 (B)	Depreciation & amortization	483		620			
研究開発費	R&D expenses	266		94			
EBITDA (A+B)	Cash flows	807		636			
1株利益 (円)	EPS (yen)	9.8		29.3			
1株EBITDA (円)	EBIDAPS (yen)	46.8		36.9			
1株配当金(単独、円)	DPS (yen)	0.0		0.0			
期末従業員数 (人)	Number of employees	2,100		2,577			

5. 期初計画と実績との差異 Review in the first half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	03/9計画(A) Original plan		03/9実績(B) Achievement			コメント
		金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	7,000	11.8	6,824	9.0	2.5	1. 連結売上高 CMSは計画を上回ったものの、装置関連及び電子デバイスの計画未達を補えなかった。 2. 売上総利益 : 上記要因に加え、売上構成の変化によるため 3. 販管費 : 全社あげての経費削減の推進により計画に近づく 4. 営業外損益 本社の為替差損 出資金評価損の発生により計画を下回った。
売上原価	Cost of sales	4,690	24.0	4,678	23.7	0.3	
売上総利益	Gross profit	2,310	6.9	2,146	13.5	7.1	
販管費	SG&A expenses	2,290	6.2	2,129	1.3	7.0	
営業利益 (A)	Operating Income	20	93.8	16	####	20.0	
営業外損益	Other income & expense	200	-	284	-	-	
経常利益	Recurring income	180	-	267	-	-	
特別損益	Extraordinary gain & loss	320	-	276	-	-	
税前利益	Income before taxes	500	-	543	-	-	
法人税等	Income tax & others	0	-	44	-	-	
中間当期利益	Net income	500	-	499	-	-	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		03/9計画(A) Original plan		03/9実績(B) Achievement			コメント
製品	Product Lines	金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	計画比 B/A	
真空シール 部品	Vacuum Feedthroughs	1,440	13.7	1,436	14.0	0.3	1. 装置関連 : 石英製品と真空シール (欧米) の計画未達が原因 地政学的リスク (イラク戦争) 及びSARSの影響で半導体生産が予想程伸びなかったことに加え、中国への生産移管がやや遅れた。 また、半導体製造設備の需要低迷により価格競争も日米で激化。 真空シール (国内) はFPDが堅調で、ほぼ計画通りとなった。 2. 電子デバイス 磁性流体 - その他に含まれるSMTの計画未達 磁性流体は前期好調の反動でやや下げたが、スピーカー業界は堅調 コンピュータシールは国外ユーザーの生産調整のため若干遅れが生じた。サーモモジュールは堅調に推移した。 3. CMS事業 : SARSの影響により、日本からのウエーハ加工設備の移管が遅れたものの、事業立上げに成功。既存受託事業は順調であった。
石英製品	Quartz	1,440	29.1	1,216	9.1	15.6	
シリコン製品	Silicon products	410	-	389	-	5.1	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	680	8.8	737	17.9	8.4	
装置関連	Equipment related	3,970	16.4	3,778	10.7	4.8	
コンピュータシール	Computer Seals	690	29.1	652	33.0	5.5	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	800	51.8	805	52.8	0.6	
ハードディスク関連	HDD products	40	81.2	0	-	-	
磁性流体 その他	Ferrofluid & Others	510	20.9	363	43.7	28.8	
電子デバイス	Electronic devices	2,040	13.4	1,820	####	10.8	
受託生産	CMS	990	101.2	1,227	149.4	23.9	
売上高合計	Total Sales	7,000	11.8	6,824	9.0	2.5	

6. 連結損益計算書 (計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen、%)

科目	Title of account	03/3		04/3e		前期比 GrowthRate	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	12,845	100.0	15,700	100.0	22.2	為替レート:1ドル=110円(期初計画120円) 1. 売上高:ウエーハ加工の伸長により増収。 2. 粗利率:CMSの構成比上昇で粗利率低下。 3. 販管費:賃金カットなどのコスト削減により増収ながら販管費は微減。 4. 営業外損益:支払利息3億円程度を見込む。 5. 特別損失:石英国内工場の一部閉鎖などの費用
売上原価	Cost of sales	8,200	63.8	10,990	70.0	34.0	
売上総利益	Gross profit	4,644	36.2	4,710	30.0	1.4	
販管費	SG&A expenses	4,533	35.3	4,259	27.1	6.0	
営業利益(A)	Operating Income	111	0.9	450	2.9	305.4	
営業外損益	Other income	738	5.7	680	4.3	7.9	
経常利益	Recurring income	626	4.9	230	1.5	-	
特別利益	Extraordinary gain	162	1.3	56	0.4	-	
特別損失	Extraordinary loss	362	2.8	386	2.5	6.6	
税前利益	Income before taxes	827	6.4	560	3.6	-	
法人税等	Income tax & others	72	0.6	60	0.4	16.7	
当期利益	Net income	899	7.0	620	3.9	-	

設備投資	Capital expenditures	2,372		1,600			サーモジュール増産投資及びシリコンウェーハ加工追加投資等
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,101		1,300			
研究開発費	R&D expenses	351		200			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,212		1,750			

1株当たり利益(円)	EPS(yen)	52.23		35.95		
1株当たりEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	70.27		101.46		
1株当たり配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00		
期末従業員数(人)	Number of employees	2,700		2,600		

* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

	03/3			04/3e		
	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)
売上高 Net Sales	5,225	12,845	2.5	7,550	15,700	2.1
営業利益 Operating Income	78	111	-	40	450	11.3
経常利益 Recurring income	72	626	-	190	230	1.2
当期利益 Net income	75	899	12.0	7	620	-

7. 期初計画と修正計画との差異 Outline of the revised plan

(単位 百万円/Unit Mil.Yen、%)

科目	Title of account	04/3期初計画(A) Original plan		04/3修正計画(B) Revised plan			コメント
		金額 Mil.Yen	前期比 yoy	金額 Mil.Yen	前期比 yoy	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	16,000	24.6	15,700	22.2	1.9	1. 連結売上高： CMSは計画を上回るものの、装置関連を中心に回復がやや鈍い。 また、為替レートの見直しによる海外子会社売上の修正。 2. 売上総利益 売上構成の変化による 3. 販管費 経費削減の継続と下半期の円高により計画を修正 4. 営業外損益： 9月以降の円高に伴い、海外子会社保有の円建債務に対する 為替評価損を見込む。(下期1.8億)
売上原価	Cost of sales	10,810	31.8	10,990	34.0	1.7	
売上総利益	Gross profit	5,190	11.8	4,710	1.4	9.2	
販管費	SG&A expenses	4,500	0.7	4,259	6.0	5.4	
営業利益(A)	Operating Income	690	521.6	450	305.4	34.8	
営業外損益	Other income	290	-	680	-	-	
経常利益	Recurring income	400	-	230	-	-	
特別利益	Extraordinary gain	0	-	56	-	-	
特別損失	Extraordinary loss	334	7.7	386	6.6	15.6	
税前利益	Income before taxes	66	-	560	-	-	
法人税等	Income tax & others	56	22.2	60	16.7	7.1	
当期利益	Net income	10	-	620	-	-	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		04/3期初計画(A) Original plan		04/3修正計画(B) Modification plan			コメント
製品	Product type	金額 Mil.Yen	前期比 yoy	金額 Mil.Yen	前期比 yoy	計画比 B/A	
真空シール 部品	Vacuum Feedthroughs	3,040	5.2	2,866	10.7	5.7	1. 装置関連： 半導体設備投資、半導体生産共に期初予想に比べ回復が鈍い。 足元の受注は好調に転じる。 2. 電子デバイス (1) コンピュータシール：サーバ関連が引き続きBBモーター採用に より現状維持。 (2) サーモモジュール：自動車温調シート向けが計画通り推移。 (3) 磁性流体 その他 受注低迷によるSMT(基板実装)の計画修正。 SMTは下半期中に中国に完全移管を計画 3. CMS事業 既存受託品が徐々に拡大。出遅れたウエーハ加工も遅れを取戻す努力 を継続。二次電池は本格稼働。
石英製品	Quartz	3,110	35.6	2,786	21.5	10.4	
シリコン製品	Silicon products	1,070	-	919	-	14.1	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,400	3.8	1,327	1.6	5.2	
装置関連	Equipment related	8,620	25.8	7,898	15.3	8.4	
コンピュータシール	Computer Seals	1,320	16.7	1,342	15.3	1.7	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,750	57.7	1,755	58.1	0.3	
ハードディスク関連	HDD products	40	88.0	0	100.0	-	
磁性流体 その他	Ferrofluid & Others	1,040	16.3	723	41.8	30.5	
電子デバイス	Electronic devices	4,150	2.8	3,820	10.6	8.0	
受託生産	CMS	3,230	87.6	3,982	131.2	23.3	
売上高合計	Total Sales	16,000	24.6	15,700	22.2	1.9	

8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	02/9	03/9	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	116	543	
減価償却費 Depreciation and Amortization	483	620	
売上債権の増減額 Changes in Notes and accounts recievable	373	102	
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	319	2	
仕入債務の増減額 Changes in Notes and accounts payable	259	23	
その他 Others	449	705	
. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	135	701	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	874	910	中国工場設備投資
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	423	43	
投資有価証券、有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	167	327	主にアメリゴン株式の追加取得
子会社株式及関連会社株式の取得又は追加取得による支出 Payments for purchase of Subsidiary stock	482	-	
貸付の実行による支出 Payments for a loan	-	31	主にダイヤセルテック向け貸付
その他 Others	118	68	
. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	1,218	1,293	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	1,679	144	短期借入れから長期借入れへのシフトによる
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt	968	1,679	長期借入れの主な実績 フェローテック:700百万円 杭州:467百万円 上海:438百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term debt	908	1,271	長期借入金の主な返済実績 フェローテック:822百万円
配当金の支払額 Payments for dividend	171	136	
その他 Others	4	59	
. 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from Financing activities	1,572	69	
. 現金及び現金等価物の中間期末残高 Cash & Cash Equivalent	3,967	2,336	

9. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)

事業別 Operations in Business Segments

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period		03/3上	03/3下	03/3通期	構成比	増減率	04/3上	増減率	04/3下	増減率	04/3通期	構成比	増減率
製品 Product Lines		1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	Growth Rate	1st Half	GrowthRate	2nd Half	GrowthRate	Year Ended	Share	GrowthRate
真空シール 部品	Vacuum Feedthroughs	1,669	1,539	3,208	25.0	18.4	1,436	14.0	1,430	7.1	2,866	18.3	10.7
石英製品	Quartz	1,115	1,178	2,293	17.9	24.8	1,216	9.1	1,570	33.3	2,786	17.7	21.5
シリコン製品	Silicon related products	-	-	-	-	-	389	-	530	-	919	5.9	-
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	625	724	1,349	10.5	36.8	737	17.9	590	18.5	1,327	8.5	1.6
装置関連	Equipment Related	3,412	3,441	6,851	53.3	24.8	3,778	10.7	4,120	19.7	7,898	50.3	15.3
コンピュータシール	Computer Seals	973	612	1,585	12.3	28.2	652	33.0	690	12.7	1,342	8.5	15.3
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	527	583	1,110	8.6	24.3	805	52.8	950	63.0	1,755	11.2	58.1
ハードディスク関連	HDD products	213	119	332	2.6	28.9	0	100.0	0	100.0	0	0.0	-
磁性流体 その他	Ferrofluid & Others	645	598	1,243	9.7	12.5	363	43.7	360	39.8	723	4.6	41.8
電子デバイス	Electronic devices	2,357	1,912	4,271	33.3	14.4	1,820	22.8	2,000	4.6	3,820	24.3	10.6
受託生産	CMS	492	1,230	1,722	13.4	157.0	1,227	149.4	2,755	124.0	3,982	25.4	131.2
売上高合計	Total Sales	6,262	6,583	12,845	100.0	13.1	6,824	9.0	8,876	34.8	15,700	100.0	22.2

装置関連	Equipment related	32	119	87	-	-	27	15.6					
電子デバイス	Electronic devices	398	103	501	451.4	1.8	206	48.2					
受託生産	CMS	106	160	266	-	-	202	-					
全社	All	-	37	37	-	-	14	-					
営業利益合計	Operating Income	324	213	111	100.0	87.9	16	95.1	434	-	450		305.4

ご参考 営業利益

10. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,095	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	2,866
石英製品	Quartz	-	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,786
シリコン製品	Silicon related products	-	-	-	-	-	-	-	919
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	-	-	-	-	1,503	2,134	1,349	1,327
装置関連	Equipment Related	1,095	1,380	2,430	3,753	10,273	9,115	6,851	7,898
コンピュータシール	Computer Seals	2,211	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,342
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	410	305	410	591	1,150	893	1,110	1,755
ハードディスク関連	HDD products	481	179	502	828	880	467	332	0
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	461	208	385	966	1,547	1,421	1,243	723
電子デバイス	Electronic devices	3,563	3,778	3,884	4,970	6,162	4,990	4,271	3,820
受託生産	CMS	-	-	-	-	-	670	1,722	3,982
売上高合計	Total Sales	4,658	5,158	6,314	8,723	16,435	14,775	12,845	15,700

* 受託生産 (CMS) は03/3期から独立表示しております。

(2) 増減率 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	-	34.7	86.6	63.5	-	22.9	18.4	10.7
石英製品	Quartz	-	-	64.8	43.4	-	16.9	24.8	21.5
シリコン製品	Silicon related products	-	-	-	-	-	-	-	-
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	-	-	-	-	-	42.0	36.8	1.6
装置関連	Equipment Related	-	26.0	76.1	54.4	-	11.3	24.8	15.3
コンピュータシール	Computer Seals	-	39.6	16.2	0.1	-	14.5	28.2	15.3
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	-	25.6	34.4	44.1	-	22.3	24.3	58.1
ハードディスク関連	HDD products	-	62.8	180.4	65.0	-	46.9	28.9	100.0
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	-	54.9	85.1	150.8	-	8.1	12.5	41.8
電子デバイス	Electronic devices	-	6.0	2.8	28.0	-	19.0	14.4	10.6
受託生産	CMS	-	-	-	-	-	-	157.0	131.2
売上高合計	Total Sales	-	10.7	22.4	38.2	-	10.1	13.1	22.2

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	23.5	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	18.3
石英製品	Quartz	-	12.9	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7
シリコン関連	Silicon related products	-	-	-	-	-	-	-	5.9
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	-	-	-	-	9.1	14.4	10.5	8.5
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	-	26.8	38.5	43.0	62.5	61.7	53.3	50.3
コンピュータシール	Computer Seals	47.5	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	8.5
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	8.8	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	11.2
ハードディスク関連	HDD products	10.3	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	0.0
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	9.9	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.6
電子デバイス	Electric devices	76.5	73.2	61.5	57.0	37.5	33.8	33.3	24.3
受託生産	CMS	-	-	-	-	-	6.8	13.4	25.4
売上高合計	Total Sales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0